

2026年中国大模型一体机行业市场全景分析及未来前景展望报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2026年中国大模型一体机行业市场全景分析及未来前景展望报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1271090.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 400-700-9383、010-60343812、010-60343813

电子邮箱: kefu@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

智研咨询专家团队倾力打造的《2026年中国大模型一体机行业市场全景分析及未来前景展望报告》（以下简称《报告》）正式揭晓，是企业了解和开拓市场，制定战略方向的得力参考资料。报告从国家经济与产业发展的宏观战略视角出发，深入剖析了大模型一体机行业未来的市场动向，精准挖掘了行业的发展潜力，并对大模型一体机行业的未来前景进行研判。本报告分为大模型一体机行业发展概述、大模型一体机行业发展现状分析、大模型一体机行业产业链分析、大模型一体机行业市场竞争格局分析、大模型一体机行业主要参与者对比分析、大模型一体机行业发展趋势、风险预警、行业发展战略与建议等主要篇章，共计7章，涉及大模型一体机出货量、市场规模等核心数据。

报告中所有数据，均来自官方机构、行业协会等公开资料以及深入调研获取所得，并且数据经过详细核实和多方求证，以期为行业提供精准、可靠和有效价值信息！

大模型一体机是一种高度集成的、提供大模型应用能力的系统。它通常采用私有化部署方式，封装人工智能应用所需要的复杂组件，提供一种简化、高效且安全的部署与运行环境。其核心理念在于对硬件资源、软件资源、模型资源及垂直领域应用进行深度整合与协同优化，构建一个易用性高的一站式人工智能解决方案，降低企业或机构部署和应用人工智能技术的门槛。大模型一体机产业链上游包括硬件供应商、软件供应商、模型供应商。中游为大模型一体机生产制造，负责大模型一体机的架构设计、硬件选型与集成、软件系统集成以及算法优化，确保各组件协同高效运行，满足大模型训练与推理的复杂需求。下游为大模型一体机应用领域，广泛用于制造、金融、政务、教育、能源等行业。

数据显示，2025年中国大模型一体机出货量约为15万台，依托于人工智能底层技术、算力技术与工程化技术的全方位突破，大模型一体机实现了从“实验室科研模型”到“工业化落地产品”的跨越。未来，行业增长曲线将持续陡峭上行，预计2026年出货量将飙升至39万台，市场规模突破2937亿元；2027年出货量有望进一步达到72万台。

2026年大模型一体机采购招标较为活跃，公安、金融、医疗、政务等数据敏感型行业受合规约束无法将核心数据上公有云，一体机成为本地化部署的最优解，中标金额从数十万元到数百万元，中标金额高企的项目多为“服务+持续运营”性质，产业价值正从“卖盒子”向“卖能力”迁移。

当前大模型一体机行业处于高速扩张、快速迭代的成长期，尚未形成绝对垄断格局，但头部集中趋势显著，同时市场呈现多主体竞逐、差异化落地的核心特征。主要参与者包括：（1）硬件与服务器企业：以浪潮通用软件有限公司、华为为代表。（2）云计算厂商：以百度百舸/千帆一体机、深信服为代表。（3）大模型和AI基础设施创企：以商汤科技、云轴科技ZStack、星环科技、阡视科技、九章云极DataCanvas为代表。（4）运营商及行业应用开

发商：以移动云、天翼云、联通数智为代表。截至2025年10月，布局企业中，34.0%的企业仅推出推理一体机，17.0%的企业仅推出训推一体机，同时推出推理一体机和训推一体机的企业占比48.9%。可以看出目前产业落地大模型一体机还是以推理一体机为主导。

报告目录：

第一章大模型一体机行业发展概述

第一节 行业定义与分类

一、大模型一体机概念界定

二、产品分类体系

1、按产品形态分类

2、按功能定位分类

第二节 行业发展历程

一、信创启动与初代一体机试水

二、大模型爆发与一体机产品化

三、DeepSeek 驱动规模化落地

第三节 大模型一体机行业商业模式分析

一、行业典型商业模式类型

二、行业收入结构与盈利模式分析

三、行业价值链环节与利润分配格局

第四节 大模型一体机行业进入壁垒分析

一、国产算力芯片适配与软硬协同技术壁垒

二、信创资质与等保安全准入壁垒

三、政企客户渠道与生态绑定壁垒

四、GPU等核心部件资金占用资本壁垒

五、大模型蒸馏微调工程化能力壁垒

第五节 大模型一体机行业退出壁垒分析

一、GPU 及服务器资产专用性与沉没成本

二、AI研发与交付人才安置调整壁垒

三、政企长期服务合约与供应链绑定

第二章 大模型一体机行业发展现状分析

第一节 2021-2025年大模型一体机产量规模分析

第二节 2021-2025年大模型一体机市场需求分析

第三节 2021-2025年大模型一体机市场规模与结构分析

第四节 2021-2025年大模型一体机价格走势分析

第五节 2021-2025年大模型一体机价格影响因素分析

第六节 DeepSeek 开源大模型引爆私有化部署需求

第七节 华为昇腾国产算力一体机规模化交付

第八节 人工智能+行动与算力基建政策加码

第三章 大模型一体机行业产业链分析

第一节 大模型一体机行业产业链图谱分析

第二节 上游硬件行业发展现状及趋势

1、GPU市场分析

2、CPU市场分析

3、存储设备市场分析

4、网络设备市场分析

第三节 上游软件行业发展现状及趋势

1、操作系统市场分析

2、AI平台软件市场分析

第四节 大模型一体机下游行业分析

一、大模型一体机下游行业分布

二、政务行业发展现状及趋势

三、金融行业发展现状及趋势

四、教育行业发展现状及趋势

第五节 上下游产业链对大模型一体机行业影响分析

第四章 大模型一体机行业市场竞争格局分析

第一节 竞争主体与梯队格局

一、华为昇腾生态系一体化厂商集群

二、传统服务器龙头厂商自研布局

三、AI算法与模型厂商软硬一体切入

四、信创国家队与系统集成商

第二节 整体竞争格局与竞争特点

一、信创国产替代驱动格局重构

三、价格下探与同质化加剧的盈利压力

第三节 行业竞争关键成功要素分析

一、国产算力适配与软硬协同优化能力

二、大模型蒸馏微调与行业知识库工程能力

三、信创资质与政企客户渠道壁垒

第四节 替代品与潜在进入者竞争分析

第五章 大模型一体机行业主要参与者对比分析

第一节 华为技术有限公司

- 一、公司基本情况分析
- 二、公司经营情况分析
- 三、公司竞争力分析

第二节 新华三集团

- 一、公司基本情况分析
- 二、公司经营情况分析
- 三、公司竞争力分析

第三节 浪潮信息

- 一、公司基本情况分析
- 二、公司经营情况分析
- 三、公司竞争力分析

第四节 中科曙光

- 一、公司基本情况分析
- 二、公司经营情况分析
- 三、公司竞争力分析

第五节 上海问道以芯科技有限公司

- 一、公司基本情况分析
- 二、公司经营情况分析
- 三、公司竞争力分析

第六节 太极计算机股份有限公司

- 一、公司基本情况分析
- 二、公司经营情况分析
- 三、公司竞争力分析

第六章 大模型一体机行业发展趋势、风险预警

第一节 行业发展趋势研判

- 一、国产算力自主化成为一体机主线
 - 1、昇腾等国产芯片占比持续提升
 - 2、软硬协同优化取代堆算力路线
 - 3、信创适配从可用走向好用
- 二、行业垂直化与场景定制深化
 - 1、通用一体机向行业专有机型分化
 - 2、行业知识库成为差异化核心
 - 3、轻量化边缘一体机打开中小市场

三、私有化部署从大客户向中小渗透

- 1、政务金融率先规模落地
- 2、成本下探驱动中小企业上一体机
- 3、租赁与订阅降低使用门槛

四、生态化竞争取代单品竞争

- 1、模型厂与硬件厂深度捆绑
- 2、开源模型重塑一体机价值链
- 3、应用商店模式初现

第二节 行业投资风险预警

一、政策与监管风险预警

- 1、美国出口管制升级致高端算力受限风险
- 2、数据安全合规趋严抬高部署门槛风险
- 3、信创目录调整引发技术路线摇摆风险

二、市场与需求风险预警

- 1、公有云替代致私有化需求不及预期风险
- 2、产品同质化引发价格战利润侵蚀风险
- 3、政企预算收缩延缓采购节奏风险

三、技术与替代风险预警

- 1、大模型架构迭代致硬件快速过时风险
- 2、云端推理成本骤降削弱本地部署必要性风险
- 3、开源模型普及压缩一体机软件溢价风险

四、竞争格局风险预警

- 1、头部云厂商降维挤压专业厂商风险
- 2、芯片厂向上游整机延伸的渠道冲突风险

五、供应链与成本风险预警

- 1、高端 GPU 与 HBM 供给波动的交付风险
- 2、国产芯片良率爬坡不及预期成本风险
- 3、内存与光模块涨价侵蚀毛利风险

第七章 行业发展战略与建议

第一节 构建国产算力软硬协同的核心技术体系

- 一、软硬协同优化能力是下一阶段分水岭
- 二、国产芯片适配深度决定交付稳定性
- 三、自主推理引擎成差异化护城河

第二节 深耕行业场景打造差异化解决方案

- 一、行业知识库壁垒高于通用能力

二、标杆案例复制是规模化的关键路径

三、轻量化产品覆盖长尾中小客户

第三节 绑定生态伙伴共建一体机开放体系

一、与模型厂深度联调成标配

二、渠道下沉需借力系统集成商

三、运维服务订阅化提升客户黏性

第四节 优化供应链与成本管控抵御周期波动

一、多元芯片供应降低单点依赖

二、库存与交付节奏匹配需求波动

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1271090.html>